

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年1-3月计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值

损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计9,926,609.46元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年1-3月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年4月19日